(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. November 2011 (24.11.2011)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2011/144226 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 25/065 (2006.01) *H01L 21/68* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2010/003119

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Mai 2010 (20.05.2010)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **EV GROUP E. THALLNER GMBH** [AT/AT]; 1, Dl Erich Thaliner Straße, AT- 4782 St. Florian am Inn (AT).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **WIMPLINGER, Markus** [AT/AT]; 84, Braunauer Straße, AT- 4910 Ried im Innkreis (AT).

(74) Anwälte: **SCHWEIGER, Johannes** et al.; Becker & Müller, Turmstraße 22, 40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

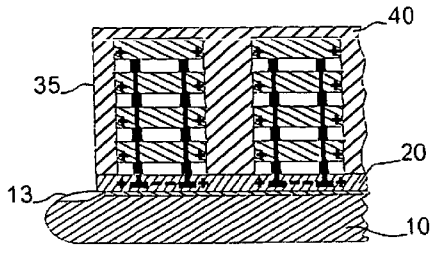
Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING CHIP STACKS, AND A CARRIER FOR CARRYING OUT THE METHOD

(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHIPSTAPELN SOWIE EINEN TRÄGER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS

Fig. 11 H5



(57) Abstract: The present invention relates to a method for producing chip stacks (31) having the following method sequence: a base layer (20), particularly a dielectric and/or photopatternable base layer, is applied to one carrier side (15) of a carrier (10), the carrier side (15) of which is provided with an adhesively active adhesion zone (14) and a less adhesively active support zone (11), wherein the base layer (20) is applied to a large extent over the full surface area of at least the support zone (11), the chip stacks (31) are set up on the base layer (20), the chip stacks (31) are cast integral, the carrier (10) is detached from the base layer (20). The invention also relates to a carrier for carrying out this method.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Chipstapeln (31) mit folgendem Verfahrensablauf: Aufbringen einer, insbesondere dielektrischen und/oder photostrukturierbaren Basisschicht (20) auf eine Trägerseite (15) eines Trägers (10), der an seiner Trägerseite (15) mit einer adhäsiv wirkenden Adhäsionszone (14) sowie einer weniger adhäsiv wirkenden Stützzone (11) versehen ist, wobei die Basisschicht (20) zumindest auf die Stützzone (11) weitgehend vollflächig aufgebracht wird, Aufbauen der Chipstapel (31) auf der Basisschicht (20), Eingießen der Chipstapel (31), Lösen des Trägers (10) von der Basisschicht (20). Außerdem betrifft die Erfindung einen Träger für die Durchführung dieses Verfahrens.

WO 2011/144226 A1